



(China)

In the future, HBM production is expected to adopt W2W technology: improving yield and reducing costs – August 4, 2023

未来HBM生产有望采用W2W技术：提升良率，降低成本

来源:闪存市场 发布时间:2023-08-04

据韩媒报道，EV Group 韩国总经理 Justin Yun在某技术会议上表示，目前在DRAM领域应用晶圆到晶圆 (W2W) 技术的研究非常活跃，因为 W2W 混合接合解决方案的应用可以提高高带宽内存等产品的生产率。

据CFM闪存市场了解，EV Group是总部位于奥地利的 一家后端芯片公司，主要产品包括晶圆键合、薄晶圆加工和光刻/纳米压印光刻 (NIL) 设备、光刻胶涂布机以及清洁和检测/计量系统。

Justin Yun表示，由于目前仍存在一些缺陷，离W2W技术真正商业应用仍需一段时日。一旦良率问题得到解决，该技术将应用于HBM生产。与其他粘合方法相比，W2W在价格上会更有竞争力。

在3D芯片产品中，除了W2W之外，还使用Die-to-Wafer和Die-to-Die接合技术。后两种方法的良率问题较少，因为好的芯片更容易被发现。然而，在吞吐量方面，它们落后于W2W。

CMOS图像传感器和MEMS最先采用W2W，因为这些芯片使用传统节点并且良率问题更容易解决。

icspec 【芯片求购】 <https://www.icspec.com/inquiry/index/1/0>

<https://www.icspec.com/news/article-details/2212275>